

证券代码：603375

证券简称：盛景微

无锡盛景微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上）
参与单位名称 及人员姓名	财通证券、创金合信基金、兴银基金、益民基金、淡水泉（北京）资管、景顺长城基金、兴证全球基金投研、中航基金、瑞达基金、银华基金、广东正圆私募基金、中银基金、禾永资管、华夏久盈资管、中银国际、大家资管、拾贝投资、东吴基金、摩根士丹利华鑫基金、上海梵星私募基金、青骊资管、中信建投
时间	2024年5月6日-5月10日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：潘叙 证券事务代表：张珊珊 证券事务专员：汪琪
投资者关系活动 主要内容介绍	问题交流： Q1：公司产品成本下降有哪些原因？ A：由于半导体成本下降，产品结构调整，产品成本整体是下降的，公司在稳定高价产品的同时也推出了高性价比的普通型产品。公司拥有专业的芯片技术团队，具有专业的技术、方案设计能力和成本规模优势。 Q2：公司产品的应用情况？ A：公司主要产品电子控制模块主要应用于隧道、地铁、基建和矿山开采等爆破领域。公司抗振性电子控制模块，可以很好地在恶劣环境下有效使用，可应用于-40℃~+85℃的宽温环

境、高过载冲击和电磁干扰环境下的地下小断面金属矿爆破、对可靠性要求较高的大型抛掷爆破、大规模拆除爆破等特殊领域，属于全场景适用，中低价产品属于部分场景适用。公司产品主要应用于工业电子雷管爆破行业，应用难点：1、失效分析，实验室和实际环境差异大：温度、湿度、震动、辐射、磁场等变化因素；2、性能要求互斥：可靠性、安全性、经济性互斥，材料可靠、冗余设计统一。

Q3：公司高低价产品占比情况如何，低价产品推出顺利吗？中低价产品销售上升后，毛利率会下降吗？

A：电子雷管全面替代后，下游客户竞争加剧，中低价产品使用占比扩大较快，高价产品使用占比逐步缩小。23、24年公司新产品推广后，市场反应积极，公司基于安全性、可靠性、稳定性的考虑，对于产品的推广相对谨慎，需要经过验证、小批量应用和大批量替代的逐步上量过程，避免出现产品在终端客户出现问题。2024年一季度以来，随着产品线完善，中低价产品占比已逐步提升至20%左右。中低价产品的配置选材不同，应用环境简单，价格相对便宜，毛利率比较稳定。

Q4：工业雷管整体下降，公司产品还有市场增长空间吗？

A：2024年第一季度工业雷管市场总量略有增长，公司核心客户所在省份区域有所下降。随着经济变化，总体市场会有上下波动。随着电子雷管效率提高，使用管理方面完善，整体使用量会有所下降。随着市场竞争的加剧，普通型电子控制模块需求量占比快速增长，应用于民爆行业电子控制模块市场仍有深度挖掘的空间，公司将在保持抗振型电子控制模块销售的基础上，顺应市场需求的变化，拓宽产品品类，提高公司产品市场占有率。另外，公司也在积极开拓海外市场和布局其他新领域的应用。

Q5：2023年公司市占率下降的原因？

A：2023年市占率下降，公司销量没有下降，而是电子雷管市场总量迅速扩大了。前期，公司策略主推高质高价产品，增量市场转为存量市场后，公司根据市场变化也推出普通型产品，就前面所述，公司基于产品的安全需求特性，推广过程谨慎。市场反应积极，也增加了新用户（易普力等），未来还有较大

	<p>的提升空间。新领域应用产品研发开拓也在不断加强力度，另外公司也积极布局海外市场，公司有信心在新的市场情况下提升市场占有率。</p> <p>Q6：公司开拓海外市场是指欧美、非洲还是东南亚？</p> <p>A：电子雷管在欧洲使用量较少，美国主要集中于石油开采领域。公司目前海外市场主要拓展方向：中东地区、中亚市场、非洲南美（矿产比较丰富）。公司目前已组建海外销售团队，将优先开拓最具潜力的市场。</p> <p>Q7：公司未来新领域、核心竞争力有哪些？</p> <p>A：公司核心竞争力：以芯片为载体，火工结合，高安全性要求的产品。具备这三个特点的领域，是公司的新领域拓展的方向。目前已在研发（部分已有产品）：1、应急管理方面：雪崩自然灾害预处理相关产品； 2、地质勘探特种雷管产品； 3、石油开采领域：射孔弹改造成电子式，极大提升石油开采效率，耐高温产品已在中石油石化投标，预计年内实现一定收入； 4、汽车领域：安全气囊点火控制芯片，研发周期较长，测试较严格，预计明年年底推出产品； 5、低空飞行器安全器相关产品，正在需求调研和技术对接中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月6日-5月10日